### PATENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark
(PCT Rule 61.2)	Office Box PCT Washington, D.C.20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Date of mailing: 21 October 1999 (21.10.99)	in its capacity as elected Office
International application No.: PCT/DE98/01312	Applicant's or agent's file reference: GR 97P1935P
International filing date: 11 May 1998 (11.05.98)	Priority date: 18 July 1997 (18.07.97)
Applicant: Company of the second seco	
1. The designated Office is hereby notified of its election made    X   in the demand filed with the International preliminary   15 December	Examining Authority on: 1998 (15.12.98) ational Bureau on:

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Col mbettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

J. Zahra

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

		ţ

## PATENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU			
PCT	То:			
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE  (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)  Date of mailing (day/month/year)	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Postfach 22 16 34 D-80506 München ALLEMAGNE			
08 December 1999 (08.12.99)				
Applicant's or agent's file reference GR 97P1935P	IMPORTANT NOTIFICATION			
International application No. PCT/DE98/01312	International filing date (day/month/year) 11 May 1998 (11.05.98)			
The following indications appeared on record concerning:      The applicant the inventor	the agent the common representative			
Name and Address SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2	State of Nationality State of Residence DE DE Telephone No.			
D-80333 München Germany	(089) 636-8 28 19 Facsimile No.			
	(089) 636-8 18 57 Teleprinter No.			
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the X the person X the name X the add				
Name and Address INFINEON TECHNOLOGIES AG	State of Nationality State of Residence DE DE			
StMartin-Str. 53 D-81541 München Germany	Telephone No.			
Germany	Facsimile No.			
	Teleprinter No.			
3. Further observations, if necessary:				
4. A copy of this notification has been sent to:				
X the receiving Office	the designated Offices concerned			
the International Searching Authority	X the elected Offices concerned			
the International Preliminary Examining Authority	other:			
The International Bureau f WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer  Ellen Moyse			
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38			

		·	



## VERTRAG ÜBE INTERNATIONALE ZUSAM NARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender:

MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An: SIEMENS AKTIENGESELLS GG VM Mch P/Ri Postfach 22 16 34 MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG 80506 München DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN **ALLEMAGNE** 28. Okt. 1999 **PRÜFUNGSBERICHTS** Eing. (Regel 71.1 PCT) GR Frist Absendedatum 2 7, 10, 99 (Tag/Monat/Jahr) Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts WICHTIGE MITTEILUNG GR 97P1935P Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) Internationales Aktenzeichen 18/07/1997 11/05/1998 PCT/DE98/01312 Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.



- Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

#### 4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

lst einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß dies Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt D-80298 München

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Mamell, J

Tel. +49 89 2399-2231





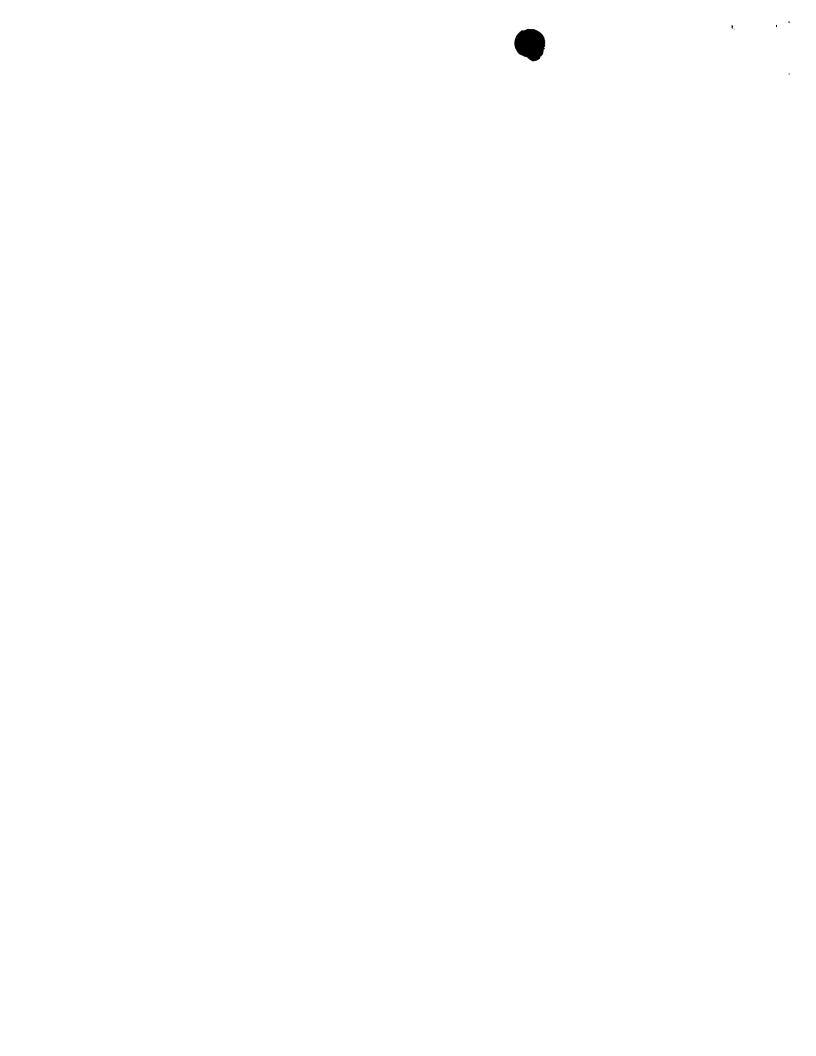
#### VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# **PCT**

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	weiteres vorgehen siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)								
GR 97P1935P									
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Tag/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)								
PCT/DE98/01312	11/05/1998 18/07/1997								
Internationale Patentklassification (IPK) oder H01L23/485	nationale Klassifikation und IPK								
Anmelder	T at al								
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	i et al.								
	üfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte nelder gemäß Artikel 36 übermittelt.								
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt	nt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.								
und/oder Zeichnungen, die geä	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dies r Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).								
Diese Anlagen umfassen insgesam	nt Blätter.								
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu f	folgenden Punkten:								
I ⊠ Grundlage des Berichts	s								
II □ Priorität									
III   Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit								
IV 🗆 Mangelnde Einheitlichk	keit der Erfindung								
V 🛛 Begründete Feststellun gewerbliche Anwendba	ng nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der arkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung								
VI 🗆 Bestimmte angeführte l	Unterlagen								
VII 🗆 Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldung								
VIII □ Bestimmte Bemerkung	gen zur internationalen Anmeldung								
Datum der Einreichung des Antrags	Datum der Fertigstellung dieses Berichts								
	Stann as i voragetenang aloos Bononto								
15/12/1998	2 7. 10. <b>99</b>								
Name und Postanschrift der mit der internatio Prüfung beauftragten Behörde:	onalen vorläufigen Bevollmächtigter Bediensteter								
Europäisches Patentamt D-80298 München	Cortes Rosa, Joao								
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 Fax: +49 89 2399 - 4465	6 epmu d  Tel. Nr. +49 89 2399 2264								



### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenz ichen PCT/DE98/01312

l. (	Grun	dlage	d s	В	richts
------	------	-------	-----	---	--------

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach

		kel 14 hin vorgelegt It beigefügt, weil sie				es Berichts	als "ur	sprunglid	n einger	eicnt" und	ı sına ınm
	Bes	chreibung, Seiten	:								
	1-9		ursprüngliche	e Fassi	ung						
	Pate	entansprüche, Nr.	:								
	1-10		ursprünglich	e Fassi	ung						
	Zeid	chnungen, Blätter:	:								
	1/4-	4/4	ursprünglich	e Fass	ung						
2.	Auf	grund der Änderung	gen sind folge	nde Ur	nterlagen fort	gefallen:					
		Beschreibung,	Seiten:								
		Ansprüche,	Nr.:								
		Zeichnungen,	Blatt:								
3.		Dieser Bericht ist o angegebenen Grü eingereichten Fas	nden nach Ai	uffassu	ng der Behör	de über dei					
4.	Etw	aige zusätzliche Be	emerkungen:								
V.	Beq gev	gründete Feststell verblichen Anwen	ung nach Art dbarkeit; Un	ikel 35 terlage	i(2) hinsichtl en und Erklär	ich der Ne rungen zur	uheit, Stütz	der erfin ung dies	derische er Fests	en Tätigk stellung	eit und dr
1.	Fes	tstellung									
	Neu	uheit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	7,9,10 1-6,8					
	Erfi	nderische Tätigkeit	(ET)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-10					
	Ge	werbliche Anwendb	arkeit (GA)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-10					



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/01312

 Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

		• • •
		-

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
  - D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 001, 31. Januar 1997 & JP 08 236767 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 13. September 1996 & US 5 698 902 A (TAKASHI UEHARA ET AL.) 16. Dezember 1997

Es sei angemerkt, daß obwohl das unter D1 zitierte US-Dokument nach dem Prioritätsdatum veröffentlicht wurde, welches von der vorliegenden Anmeldung beansprucht wird, sein Inhalt als Stand der Technik nach Artikel 64.1 PCT angesehen wird, da es in den zugehörigen, unter D1 zitierten JP Familiendokumenten vorveröffentlicht wurde. Eine Kopie besagten US-Dokuments liegt bei.

- 2. Der Gegenstand der Ansprüche 1-6 und 8 ist nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT.
- 2.1 Dokument D1 (siehe das Abstract des JP-Dokuments; Abbildung 6 und die zugehörige Beschreibung des US-Dokuments) offenbart eine integrierte Schaltungsanordnung,
  - bei der in einem Halbleitersubstrat (10) mindestens ein dotiertes Gebiet (21, 21a, 21b) vorgesehen ist,
  - bei der an der Oberfläche des Halbleitersubstrats (10) eine Ebene mit leitenden Nutzstrukturen (50a) und mindestens einer leitenden Füllstruktur (31) angeordnet ist,
  - bei der die leitende Füllstruktur (31) mit dem dotierten Gebiet (21, 21a, 21b)
     leitend verbunden ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich nicht davon.

2.2 Die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 2, 3 und 6 sind bekannt aus D1 (siehe

		•	
			-

Abbildung 6 des US-Dokuments und die zugehörige Beschreibung; Spalte 11, Zeilen 48-51 des US-Dokuments). Auch die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 4 und 5 sind im Prinzip bekannt aus D1 (siehe Abbildung 6 des US-Dokuments und die zugehörige Beschreibung).

- 2.4 Das Verfahren von Anspruch 8 ist bekannt aus D1 (siehe Spalte 13, Zeile 57 Spalte 15, Zeile 48 des US-Dokuments).
- 3. Der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 7, 9 und 10 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT. Diese Ansprüche definieren lediglich konventionell und nichterfinderische Ausführungsmöglichkeiten für die integrierte Schaltungsanordnung von Anspruch 1 bzw. das Verfahren von Anspruch 8.

		. •	` '
			•

5.T-

#### VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# **PCT**

REC'D 29 OCT 1999

WIPO PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeich	en des	Anmelders oder Anwalts	·						
GR 97P			WEITERES VORGEHE		ilung über die Übersendung des internationalen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)				
Internation	ales Al	ktenzeichen	Internationales Anmeldedatun	(Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)				
PCT/DE	98/01	312	11/05/1998		18/07/1997				
International H01L23/		tentklassification (IPK) oder i	nationale Klassifikation und IPK						
SIEMEN	S AK	TIENGESELLSCHAFT	et al.						
			fungsbericht wurde von der elder gemäß Artikel 36 über		onale vorläufigen Prüfung beauftragte				
2. Diese	er BEF	RICHT umfaßt insgesamt	5 Blätter einschließlich die	ses Deckblatts.					
ι	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).								
Diese	Anla	gen umfassen insgesam	t Blätter.						
3. Diese	er Ber	icht enthält Angaben zu f	olgenden Punkten:						
į	$\boxtimes$	Grundlage des Berichts	;						
H		Priorität							
111		Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neuheit, e	finderische Täti	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit				
IV		Mangelnde Einheitlichk	eit der Erfindung						
V	⊠		g nach Artikel 35(2) hinsicht rkeit; Unterlagen und Erklär		, der erfinderische Tätigkeit und der ung dieser Feststellung				
VI		Bestimmte angeführte l	Jnterlagen						
VII		Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldung						
VIII		Bestimmte Bemerkunge	en zur internationalen Anme	ldung					
Datum der	Einrei	chung des Antrags	Dat	um der Fertigstellu	ung dieses Berichts				
15/12/19	98				2 7. 18. 99				
	auftraç	nschrift der mit der internatio gten Behörde:	nalen vorläufigen Bev	ollmächtigter Bedi	ensteter				
<u>)</u> ))	D-80	opäisches Patentamt 0298 München +49 89 2399 - 0 Tx: 523656		rtes Rosa, Joa					
		+49 89 2399 - 4465	'	Nr. +49 89 2399 2	2264				

				•
				J

#### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/01312

1	~	ndlage		D	
١.	CSFLII	ICIACE	ues	Der	KCINIS

1.

1.	Arti	ser Bericht wurde e kel 14 hin vorgeleg nt beigefügt, weil sie	t wurden, gelt	en im F	Rahmen dies			
	Bes	schreibung, Seiten	ı:					
	1-9		ursprünglich	e Fass	ung			
	Pat	entansprüche, Nr.	:					
	1-1	0	ursprünglich	e Fass	ung			
	Zei	chnungen, Blätter	:					
	1/4	-4/4	ursprünglich	e Fass	ung			
2.	Auf	grund der Änderun	gen sind folge	nde Ur	nterlagen fort	gefallen:		
		Beschreibung,	Seiten:					
		Ansprüche,	Nr.:					
		Zeichnungen,	Blatt:					
3.		Dieser Bericht ist o angegebenen Grü eingereichten Fas	ınden nach Aı	uffassu	ng der Behör	de über der		
4.	Etw	aige zusätzliche Be	ernerkungen:					
V.		gründete Feststelle verblichen Anwen						und der
1.	Fes	tstellung						
	Neu	uheit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	7,9,10 1-6,8		
	Erfi	nderische Tätigkeit	(ET)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-10		
	Gev	werbliche Anwendb	arkeit (GA)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-10		

	ı	

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/01312

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

		•
		V

#### Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
  - D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 001, 31. Januar 1997 & JP 08 236767 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 13. September 1996 & US 5 698 902 A (TAKASHI UEHARA ET AL.) 16. Dezember 1997

Es sei angemerkt, daß obwohl das unter D1 zitierte US-Dokument nach dem Prioritätsdatum veröffentlicht wurde, welches von der vorliegenden Anmeldung beansprucht wird, sein Inhalt als Stand der Technik nach Artikel 64.1 PCT angesehen wird, da es in den zugehörigen, unter D1 zitierten JP Familiendokumenten vorveröffentlicht wurde. Eine Kopie besagten US-Dokuments liegt bei.

- 2. Der Gegenstand der Ansprüche 1-6 und 8 ist nicht neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT.
- 2.1 Dokument D1 (siehe das Abstract des JP-Dokuments; Abbildung 6 und die zugehörige Beschreibung des US-Dokuments) offenbart eine integrierte Schaltungsanordnung,
  - bei der in einem Halbleitersubstrat (10) mindestens ein dotiertes Gebiet (21, 21a, 21b) vorgesehen ist,
  - bei der an der Oberfläche des Halbleitersubstrats (10) eine Ebene mit leitenden Nutzstrukturen (50a) und mindestens einer leitenden Füllstruktur (31) angeordnet ist,
  - bei der die leitende Füllstruktur (31) mit dem dotierten Gebiet (21, 21a, 21b) leitend verbunden ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich nicht davon.

2.2 Die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 2, 3 und 6 sind bekannt aus D1 (siehe

		٠
		•

Abbildung 6 des US-Dokuments und die zugehörige Beschreibung; Spalte 11, Zeilen 48-51 des US-Dokuments). Auch die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 4 und 5 sind im Prinzip bekannt aus D1 (siehe Abbildung 6 des US-Dokuments und die zugehörige Beschreibung).

- 2.4 Das Verfahren von Anspruch 8 ist bekannt aus D1 (siehe Spalte 13, Zeile 57 -Spalte 15, Zeile 48 des US-Dokuments).
- 3. Der Gegenstand der abhängigen Ansprüche 7, 9 und 10 beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT. Diese Ansprüche definieren lediglich konventionell und nichterfinderische Ausführungsmöglichkeiten für die integrierte Schaltungsanordnung von Anspruch 1 bzw. das Verfahren von Anspruch 8.

		•
		٠
	·	

# **PCT**

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	Recherchenberichts (	die Übermittlung des internationalen Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit
GR 97P1935P	VORGEHEN zutreffend, nachstehe	
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/DE 98/01312	11/05/1998	18/07/1997
Anmelder		
   SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	ot al	•
STEPIENS ARTIENGESELLSCHAFT	ec ai.	
Dieser internationale Recherchenbericht wur Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Ir	de von der Internationalen Recherchenbehörde ( ternationalen Büro übermittelt.	erstellt und wird dem Anmelder gemäß
Dieser internationale Recherchenbericht umf  X  Darüber hinaus liegt ihm jeweils e	aßt insgesamt <u>3</u> Blätter. eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unte	rlagen zum Stand der Technik bei.
1 Rectimente Ancordiche haben e	ich als nichtrecherchierbar erwiesen (siehe F	ald I)
1. Bestimmte Ansprüche haben s	ich als mentrecherenterbar erwiesen (Siehe )	ыч ().
2. Mangelnde Einheitlichkeit der f	Erfindung(siehe Feld II).	
3. In der internationalen Anmeldung	ist ein Protokoll einer Nucleotid- und/oder Ar	ninosäuresequenz offenbart; die internationale
Recherche wurde auf der Grundl	age des Sequenzprotokolls durchgeführt,	
	usammen mit der internationalen Anmeldung eir om Anmelder getrennt von der internationalen A	
	dem jedoch keine Erklärung beigefügt war, d	
		eldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.
das	von der Internationalen Recherchenbehörde in d	lie ordnungsgemäße Form übertragen wurde.
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfine	dung	
X wird	der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehm	nigt.
wurd	e der Wortlaut von der Behörde wie folgt festges	etzt.
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung		
	der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehn	
festg		ingegebenen Fassung von dieser Behorde echerchenbehörde innerhalb eines Monats nach echerchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.
·		
6. Folgende Abbildung der <b>Zeichnungen</b> is	st mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen:	
	om Anmelder vorgeschlagen	keine der Abb.
I 🚝	der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschla	
weil o	diese Abbildung die Erfindung besser kennzeich	let.
1		

		•	•
•			

a. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 H01L23/485 H01L21/768

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu

IPK 6 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 001, 31. Januar 1997 & JP 08 236767 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), 13. September 1996 siehe Zusammenfassung & US 5 698 902 A (TAKASHI UEHARA ET AL.) 16. Dezember 1997	1,8
X	US 4 945 067 A (HUANG TIAO-YUAN) 31. Juli 1990 siehe Zusammenfassung	1,8
Α	US 5 441 915 A (LEE JIN-YUAN) 15. August 1995 siehe Abbildung 12/	1,8

<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:</li> <li>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> </ul>	<ul> <li>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach deminternationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist</li> <li>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden</li> <li>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen</li> </ul>			
<ul> <li>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> </ul>	werden, wenn die Verörtertlichung mittelner oder mehreren ander Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist			
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts			
26. Oktober 1998	10/11/1998			
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter			
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Königstein, C			

Siehe Anhang Patentfamilie

			. •	•
·				



hationales Aktenzeichen
PCT/DE 98/01312

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	Total Assessed Mil
Kategorie?	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	D. WIDMANN, H. MADER, H.FRIEDRICH: "Technologie hochintegrierter Schaltungen" SPRINGER VERLAG,1996, Seiten 346-347, XP002082112 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument	

		•
	·	

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

national Application No
PCT/DE 98/01312

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
US 4945067	А	31-07-1990	US DE DE EP JP	4907041 A 68910249 D 68910249 T 0359528 A 2135780 A	06-03-1990 02-12-1993 19-05-1994 21-03-1990 24-05-1990	
US 5441915	Α	15-08-1995	US	5789313 A	04-08-1998	



Translation



# **PCT**

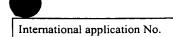
## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

			. C. T Intermetional			
Applicant's or agent's file reference GR 97P1935P	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416					
International application No.	International filing date (day)	month/year)	Priority date (day/month/year)			
PCT/DE98/01312	11 May 1998 (11.0:	5.1998)	18 July 1997 (18.07.1997)			
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01L 23/485						
Applicant INFINEON TECHNOLOGIES AG						
Authority and is transmitted to the a	applicant according to Article 3	6.	International Preliminary Examining			
2. This REPORT consists of a total of	sneets, includ	ing this cover s	sileet.			
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).						
These annexes consist of a total of sheets.						
3. This report contains indications relating to the following items:						
I Basis of the report						
II Priority						
III Non-establishmer	III Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability					
, IV L	IV Lack of unity of invention					
V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement						
VI Certain documents cited						
VII Certain defects in the international application						
VIII Certain observations on the international application						
Date of submission of the demand	Date	of completion	of this report			
Date of submission of the demand						
15 December 1998 (15.	12.1998)	27 (	October 1999 (27.10.1999)			
Name and mailing address of the IPEA/EP European Patent Office D-80298 Munich, Germany	Auth	Authorized officer				
Facsimile No. 49-89-2399-4465	Tele	Telephone No. 49-89-2399-0				







# PCT/DE98/01312

I. Basis of the report						
1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):						
	the international	application as originally filed.	,			
$\boxtimes$	the description,	pages1-9	_, as originally filed,			
		pages	_, filed with the demand,			
		pages	_, filed with the letter of,			
		pages	_, filed with the letter of			
	the claims,	Nos. 1-10	_ , as originally filed,			
•	•	Nos	, as amended under Article 19,			
		Nos.	_, filed with the demand,			
		Nos	, filed with the letter of,			
		Nos.	_ , filed with the letter of			
	the drawings,	sheets/fig1/4-4/4	_ , as originally filed,			
•	•	sheets/fig	_, filed with the demand,			
		sheets/fig	, filed with the letter of,			
		sheets/fig	, filed with the letter of			
2. The amer	ndments have resulte	ed in the cancellation of:				
	the description,	pages				
	the claims,	Nos				
	the drawings,	sheets/fig				
	o a.a.v.m.g.s,					
			nendments had not been made, since they have been considered as Supplemental Box (Rule 70.2(c)).			
	go boyona me alsen	osare as more as more are in the	c supplemental Box (state 70.2(0)).			
4. Addition	al observations, if ne	ecessary:				
ā						
			•			



#### INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

ernational application No.
PCT/DE 98/01312

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	7, 9, 10	YES
		Claims	1-6, 8	NO
	Inventive step (IS)	Claims		YES
		Claims	1-10	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES
		Claims		NO NO

#### 2. Citations and explanations

- 1. This report makes reference to the following documents:
  - D1: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Vol. 097, No. 001, 31 January 1997 & JP-A-08 236 767 (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO. LTD.), 13 September 1996 & US-A-5 698 902 (TAKASHI UEHARA ET AL.), 16 December 1997.

It is noted that although the US document cited under D1 was published after the priority date claimed by the present application, its content is considered prior art under PCT Article 64.1 because it was previously published in the associated JP document of the same family cited under D1. A copy of said US document is annexed.

- 2. The subject matter of Claims 1-6 and 8 is not novel
  ----within the meaning of PCT Article 33(2).
- 2.1 Document D1 (see abstract of JP-A-08 236 767; Figure
  6 and associated description of US-A-5 698 902)
  discloses an integrated circuit arrangement in which
   at least one doped region (21, 21a, 21b) is



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

provided in a semiconductor substrate (10);

- a plane with conducting usable structures (50a) and at least one conducting filling structure (31) is arranged at the surface of the semiconductor substrate (10);
- the filling structure (31) is conductively connected to the doped region (21, 21a, 21b).

The subject matter of Claim 1 does not differ from this prior art.

- 2.2 The additional features of Claims 2, 3 and 6 are known from D1 (see US-A-5 698 902, Figure 6 and associated description, as well as column 11, lines 48-51). The additional features of Claims 4 and 5 are also in principle known from D1 (see US-A-5 698 902, Figure 6 and associated description).
- 2.3 The process as per Claim 8 is known from D1 (see column 13, line 57, to column 15, line 48 of US-A-5 698 902).
- 3. The subject matter of dependent Claims 7, 9 and 10 does not involve an inventive step within the meaning of PCT Article 33(3). These claims only define conventional and non-inventive configurations of the integrated circuit arrangement as per Claim 1 or process as per Claim 8.

· \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_



		From the INTERNATIONAL BUREAU			
PCT	To:	То:			
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE  (PCT Rule 92bis.1 and	l n	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Postfact 22 16 34 D-80506 München 7. C32. 1999			
Administrative Instructions, Section 422)	ALL	EMAGNE			
Date of mailing (day/month/year)	ור	GR Frist			
08 December 1999 (08.12.99)		11100	And the second s		
Applicant's or agent's file reference		INADODT AND NOT	FIGATION		
GR 97P1935P		IMPORTANT NOTI	FICATION		
International application No.	1	nal filing date (day/month/ye	ear)		
PCT/DE98/01312	11 M	/lay 1998 (11.05.98)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
The following indications appeared on record concerning:					
X the applicant the inventor	the age	nt the commo	n representative		
Name and Address	<del></del>	State of Nationality	State of Residence		
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2		DE	DE		
D-80333 München Germany		Telephone No. (089) 636-8 28 19			
Germany		Facsimile No.			
		(089) 636-8 18 57			
		Teleprinter No.			
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that t  X the person X the name X the add		change has been recorded of the nationality	concerning: the residence		
Name and Address		State of Nationality	State of Residence		
INFINEON TECHNOLOGIES AG StMartin-Str. 53		DE	DE		
D-81541 München		Telephone No.			
Germany		Facsimile No.			
		Teleprinter No.			
3. Further observations, if necessary:					
3. I dittier observations, if necessary:					
4. A copy of this notification has been sent to:					
X the receiving Office	[	the designated Offices	concerned		
the International Searching Authority	[	X the elected Offices cond	cerned		
the Internati nal Preliminary Examining Auth rity	[	ther:			
The leteranti and Down of Mana	Authorized	fficer	(,)		
The Internati nal Bureau of WIPO  34, chemin des Col mbettes		Ellen Moyse	X		
<b>1211 Geneva 20, Switzerland</b> Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Tolophore	No.: (41-22) 338.83.38			
	reichingue	140 (41-22) 330.03.38	·		

Form PCT/IB/306 (March 1994)

VENUE 991299





nmeldeamt auszufüllen	
Internationales Aktenzeichen	
Internationales Anmeldedatum	
Name des Anmeldeamts und "PCT International App	lication"
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gew	ünscht)

ANTRAG	Internationales Anmeldedatum	1
Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.	Name des Anmeldeamts und "	PCT International Application"
Patentwesens behandert wird.		
	Aktenzeichen des Anmelders o (max. 12 Zeichen)	
	<u></u>	GR 97P1935P
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Integrierte Schaltungsanordnung und Verfahren	n zu deren Herstellung	
Feld Nr. II ANMELDER		
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der N in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohn:	lame des Staats anzugeben. Der t des Sitzes oder Wohnsitzes des	Diese Person ist gleichzeitig Erfinder
Siemens Aktiengesellschaft		Telefonnr:: (089) 636-8 28 19
Wittelsbacherplatz 2		<u></u>
D-80333 München		Telefaxnr.: (089) 636-8 18 57
DE		Fernschreibnr.:
		52100-0 sie d
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	oder Wohnsitz (Staat):	DE
Diese Person ist Annelder  alle Bestime		Vereinigten die im Zusatzfeld von Amerika angegebenen Staaten
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEIT	ERE) ERFINDER	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Nin diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat danmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohn SCHWALKE, Udo Gewerbestr. 22 D-84431 Heldenstein DE	Vame des Staats anzugeben. Der des Sitzes oder Wohnsitzes des isitzes angegeben ist.)	Diese Person ist:  nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	oder Wohnsitz (Staat):	DE
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsfür folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten St		Vereinigten die im Zusatzfeld angegebenen Staaten
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf	einem Fortsetzungsblatt angegel	ben.
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRI	ETER; ZUSTELLANSCHRIF	Γ
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, u vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eige	um für den (die) Anmelder enschaft zu handeln als:	Anwalt gemeinsamer Vertreter
Name und Anschrift: (Familiername, Vorname; bei juristischen Persone Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Nam	n vollständige amtliche Bezeichnung. 1e des Staats anzugeben)	Telefonnr.: (089) 636-8 28 19
Siemens Aktiengesellschaft Postfach 22 16 34		Telefaxnr.: (089) 636-8 18 57
D-80506 München DE		Fernschreibnr.: 52100-0 sie d
Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.	r gemeinsamer Vertreter bestellt	ist und statt dessen im obigen Feld

		*	٠,٠
<del>_</del>			

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE)	ERFINDER						
	Wird keines der folgenden Felder benutzt, so ist dieses Blatt dem Antrag nicht beizufügen.						
Name und Anschrist: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtlici Bezeichnung. Bei der Anschrist sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. D in diesem Feld in der Anschrist angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sosem nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)  LUDWIG, Burkhard  Halskestr. 26  D-81379 München  DE	he						
Staatsangehörigkeit (Staat):  DE  Sitz oder Wohnsitz (Staat):	DE						
für folgende Staaten: mungsstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika Staat	die Vereinigten die im Zusatzfeld ten von Amerika angegebenen Staaten						
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtlic Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. D in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	Diese Person ist:  nur Anmelder  Anmelder und Erfinder  nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)						
Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat):							
	die Vereinigten die im Zusatzfeld angegebenen Staaten						
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtlic Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. L in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	er   Diese i cison ist.						
Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat):							
für folgende Staaten: mungsstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika	Jer   Diese Ferson ist.						
Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat):							
	die Vereinigten die im Zusatzfeld angegebenen Staaten						
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusätzlichen Fortsetzu	ngsblatt angegeben.						



Feld I	Nr. V	BESTIMMUNG VEH STAATEN			
Die fo	lgende	n Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hier	mit vo	orgenon	nmen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens
ein Käs	tchen m	uβ angeloreuzi werden):			
	nales l				
	AP	ARIPO-Pat nt: GH Ghana, KE Kenia, LS Le	sotho,	MW	Malawi, SD Sudan, SZ Swasiland, UG Uganda,
		ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragss			
	EA				larus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik
	LA	Moldan RII Russische Föderation T.I Tadschikistar	TM	Turkn	nenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des
		Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist	.,		indiana i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	PD		-n C	H und	d LI Schweiz und Liechtenstein, DE Deutschland,
لكا	EP				
					ereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT
ŀ					Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der
_		Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommer			
	OA				ikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire,
		CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, ML Mali,	MR I	Mauret	anien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo
		und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI u	nd de	s PCT	ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges
		Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten I	Linie d	angebei	n)
Natio	nales I	atent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sanstiges Verfah			
	AL	Albanien	Γĵ	LV	Lettland
ız			H		
	AM	Armenien	H	MD	Republik Moldau
	AT	Osterreich	$\sqcup$	MG	Madagaskar
	ΑU	Australien		MK	Die ehemalige jugoslawische Republik
	ΑZ	Aserbaidschan			Mazedonien
	BA	Bosnien-Herzegowina		MN	Mongolei
	BB	Barbados	$\approx$	MW	_
			H		Malawi
	BG	Bulgarien	닏	MX	Mexiko
	BR	Brasilien		NO	Norwegen
	BY	Belarus		NZ	Neuseeland
	CA	Kanada	$\overline{\Box}$	PL	Polen
		and LI Schweiz und Liechtenstein	Ħ	PT	Portugal
			$\asymp$		-
l ∐	CN	China	님	RO	Rumānien
l ∐	CU	Kuba	Ш	RU	Russische Föderation
	CZ	Tschechische Republik		SD	Sudan
	DE	Deutschland		SE	Schweden
ΙĒ	DK	Dänemark	$\overline{\sqcap}$	SG	Singapur
lΞ	EE	Estiand	Ħ	SI	Slowenien
ΙH	ES		H		
		Spanien	$\vdash$	SK	Slowakei
	FI	Finnland	$\Box$	SL	Sierra Leone
	GB	Vereinigtes Königreich		TJ	Tadschikistan
	GE	Georgien		TM	Turkmenistan
	GH	Ghana		TR	Türkei
	HU	Ungarn	Ħ	TT	Trinidad und Tobago
	ıL	<u> </u>	H		
			$\bowtie$	UA	Ukraine
	IS	Island	닖	UG	Uganda
<u>⊠</u>	JP	Japan	$\boxtimes$	US	Vereinigte Staaten von Amerika
	KE	Kenia			
	KG	Kirgisistan		UZ	Usbekistan
	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	$\overline{\Box}$	VN	Vietnam
		•	$\asymp$	YU	
			=		Jugoslawien
	KR	Republik Korea	$\Box$	ZW	Simbabwe
	KZ	Kasachstan	Kasto	hen für	die Bestimmung von Staaten (für die Zwecke eines nationalen
	LC	Saint Lucia	Paterit	s), die den	n PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind:
	LK	Sri Lanka			
	LR	Liberia	Ξ		
			님		
	LS	Lesotho	닏		
	LT	Litauen	Ш		
	LU	Luxemburg			

Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der Bestimmung von

Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestimmungs- und der Bestätigungsgehöhr. Die Bestätigung muß beim Armeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

			٠	
		·		



Feld Nr. VI PRIORITÄTSA	NSPRUCH	Weitere Prioritätsansprüche sind im Zusatzfeld angegeben.			
Die Priorität der folgenden früher	ren Anmeldung(en) wird hiermit b	eansprucht:			
Staat (Armelde- oder Bestimmungsstaat der Armeldung)	Anmeldedatum (Tag/Manat/Jahr)	Aktenzeichen	Anmeldeamt (nur bei regionaler oder internationaler Armeldung)		
(1) DE	18. Juli 1997	197 30 974.7			
(2)					
(3)					
Armedeamt ist (eine Gebühr kann verlangt  Das Anmeldeamt wird hier bezeichneten früheren Anm	w <i>erden):</i> mit ersucht, eine beglaubigte Abso leldung(en) zu erstellen und dem I	nternationalen Büro zu übermitteli			
Feld Nr. VII INTERNATION	NALE RECHERCHENBEHÖR	DE			
Recherchenbehörden für die internation die die internationale Recherche durchfü	nerchenbehörde (ISA) (Sind zwei a ale Recherche zuständig, ist der Name de hiren soll; Zweibuchstaben-Cade genüg): 1. wenn eine Recherche (internationale hörde beantragt oder von ihr durch die Ergebnisse einer solchen fritheren betweiten von der der Recherche	er Behörde anzugeben, ISA/	Art oder sonstige Recherche) bereits num ersucht wird, die internationale oder der Recherchenantrag ist durch		
Staat (oder regionales Amt):	Datum (Tag /Monat/)				
Feld Nr. VIII KONTROLLIS	TE				
Diese internationale Anmeldu		en Anmeldung liegen die nachstehe	end angekreuzten Unterlagen bei:		
l. Antrag : 4	Blätter 1. Unterzei	chnete gesonderte	Blatt für die Gebührenberechnung		
2. Beschreibung : 9	Blatter 2.   Vollmac		Gesonderte Angaben zu hinter- legten Mikroorganismen		
3. Ansprüche : 3	der Unte		Sequenzprotokolle für Nucleotide und/oder Aminosäuren (Diskette)		
4. Zusammenfassung:		sbelege(e) (durch ennummer von Feld 8.	Sonstige (einzeln aufführen):		
5. Zeichnungen : 4	Blätter Nr. VI ka	ennzeichnen): (1)			
Insgesamt : 21	Blätter				
Abbildung Nr. 6 der Zeic	chnungen (falls vorhanden) soll m	it der Zusammenfassung veröffentl	icht werden.		
	FT DES ANMELDERS ODER 1				
Der Name jeder unterzeichnenden Pe ergibt, in welcher Eigenschaft die Per			ch dies nicht eindeutig aus dem Antrag		
Siemens Aktiengesellschaf	t	4.	5.98		
i.V. Mira	Il do plus		who Muceu		
Margraf J Nr. 144/74 AngAV	Udo Schwalke		Burkhard Ludwig		
1. Datum dan Arabatatata - Et		eamt auszufüllen	2. Zeichnungen		
Datum des tatsächlichen Eing internationalen Anmeldung:			□ einge-		
Geändertes Eingangsdatum at fristgerecht eingegangener Ur zur Vervollständigung dieser	terlagen oder Zeichnungen		gangen: nicht ein- gegangen:		
4. Datum des fristgerechten Eing Richtigstellungen nach Artike	gangs der angeforderten				
Vom Anmelder benannte     Internationale Recherchenbeh			des Recherchenexemplars bis zur lecherchengebühr aufgeschoben		
	<del></del>	len Büro auszufüllen			
Datum des Einganges des Akten beim Internationalen Büro:	exemplars				



Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS Postfach 22 16 34 ODER DER ERKLÄRUNG 80506 München GERMANY ZT GG VM Mch (Regel 44.1 PCT) 1 2. NOV. 1998 Eing. Absendedatum GR (Tag/Monat/Jahr) 10/11/1998 Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts WEITERES VORGEHEN GR 97P1935P siehe Punkt 1 und 4 unten Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) PCT/DE 98/01312 11/05/1998 Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß der internationale Recherchenbericht erstellt wurde und ihm hiermit übermittelt wird. Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Artikel 19: Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche der internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46): Bis wann sind Änderungen einzureichen? Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt üblicherweise zwei Monate ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. Wo sind die Änderungen einzureichen? Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO, 34, CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Genf 20, Telefaxnr.: (41-22) 740.14.35 Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach Artikel 17(2)a) übermittelt wird. Hinsichtlich des Widerspruchsgegen die Entrichtung einer zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird dem Anmelder mitgeteilt, daß der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusammen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des Widerspruchs als auch der Entscheidung hierüber an die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermittelt worden noch keine Entscheidung über den Widerspruch vorliegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung getroffen wurde. Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht: Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffentlicht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 bzw. 90<sup>ols</sup> 3 vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen. Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch länger) verschieben möchte. Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum muß der Anmelder die für den Eintritt in die nationale Phase vorgeschriebenen Handlungen vor allen Bestimmungsämtern vornehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum in der Anmeldung oder einer nachträglichen Auswahlerklärung ausgewählt wurden oder nicht ausgewählt werden konnten, da für sie Kapitel II des Vertrages nicht v rbindlich ist. Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Marjory Sastropawiro Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,

Fax: (+31-70) 340-3016

		ĭ	<i>;</i>

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungsordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

### HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationalen Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

### Welche Telle der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

#### Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

#### Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46,2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

#### in welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Ansprüch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der dieinternationale Anmeldung veröffentlicht wird.

#### Welche Unterlagen sind den Änderungen beizufügen?

### Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19 (1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmelders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen internationalen Anmeldungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen int rnationalen Anmeldungen in französischer Sprache abzufassen.

		, ,
		·

# ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (F rtsetzung)

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der internationalen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten. Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

#### Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erläutem sind:

- [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
   Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt.
- (Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren):
   "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
- 3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]: Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
- 4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]: "Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Ansprüch 14 ersetzt; Ansprüch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

#### "Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationalen Anmeldung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den inter nationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

## Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf internationalevorläufige Prüfung

lst zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internation alen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

# Auswirkungen von Änderungen hinsichtlich der Übersetzung derinternationalen Anmeldung beim Eintritt in die nationale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

	; •

# WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

#### INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

H01L 23/485, 21/768

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 99/04431

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

28. Januar 1999 (28.01.99)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE98/01312

**A1** 

(22) Internationales Anmeldedatum:

11. Mai 1998 (11.05.98)

(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,

MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

197 30 974.7

18. Juli 1997 (18.07.97)

DE

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

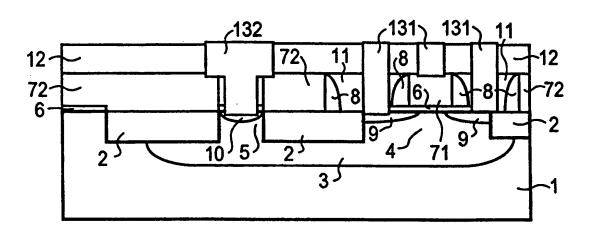
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHWALKE, Udo [DE/DE]; Gewerbestrasse 22, D-84431 Heldenstein (DE). LUDWIG. Burkhard [DE/DE]; Halskestrasse 26, D-81379 München

(54) Title: INTEGRATED CIRCUIT AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF

(54) Bezeichnung: INTEGRIERTE SCHALTUNGSANORDNUNG UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG



(57) Abstract

The invention provides for a doped area (3) of a substrate (1). A plane with conductive usable structure (71) and a conducting filling structure (72) are arranged on the surface of said substrate (1). The conducting filling structure (72) is conductively connected with the doped area (10, 3). This enables loading of the conducting filling structure (72) to be avoided, said filling structure being provided to improve the planarity of the circuit and being devoid of any technical function therein.

#### (57) Zusammenfassung

In einem Substrat (1) ist ein dotiertes Gebiet (3) vorgesehen. An der Oberfläche des Substrats (1) ist eine Ebene mit leitenden Nutzstrukturen (71) und einer leitenden Füllstruktur (72) angeordnet. Die leitende Füllstruktur (72) ist mit dem dotierten Gebiet (10, 3) leitend verbunden. Auf diese Weise wird eine Aufladung der leitenden Füllstruktur (72), die zur Verbesserung der Planarität der Schaltungsanordnung vorgesehen und keine schaltungstechnische Funktion hat, vermieden.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
ΑT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
ВЈ	Benin	ΙE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
· EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

#### Beschreibung

Integrierte Schaltungsanordnung und Verfahren zu deren Herstellung.

5

10

15

Bei der Realisierung von integrierten Schaltungsanordnungen mit hoher Packungsdichte und insbesondere mit Strukturgrößen unter 0,25 µm gewinnt die Frage der Planarität zunehmend an Bedeutung. Bei der Herstellung der integrierten Schaltungsanordnung werden auf einem Halbleitersubstrat Nutzstrukturen erzeugt, die eine schaltungstechnische Funktion in der Schaltungsanordnung haben. Derartige Nutzstrukturen sind zum Beispiel Anschlußelektroden, Gateelektroden oder Leitbahnen. Diese Nutzstrukturen sind jeweils in Ebenen durch Strukturierung einer zuvor erzeugten Schicht hergestellt. Zwischen aufeinanderfolgenden Ebenen sind Isolationsschichten vorgesehen. Diese Isolationsschichten werden durch Polieren und/oder Ätzen planarisiert.

- 20 Die erzielbare Planarität beim Planarisieren von Schichten hängt dabei von der geometrischen Dichte der Nutzstrukturen in der jeweiligen Ebene ab. Bei einer sehr ungleichmäßigen Belegung mit Nutzstrukturen ergeben sich lokal große Freiräume, in denen bei den Planarisierungsverfahren Unebenheiten 25 auftreten. Daher ist vorgeschlagen worden (siehe zum Beispiel D. Widmann, H. Mader, H. Friedrich, Technologie hochintegrierter Schaltungen, 2. Auflage, Springer-Verlag, 1996, Seite 346 bis 347) zwischen den Nutzstrukturen Füllstrukturen einzufügen, die schaltungstechnisch ohne Funktion sind, die 30 jedoch die lokale geometrische Dichte erhöhen. Dadurch wird eine gleichmäßige Belegung in der jeweiligen Ebene sichergestellt, die eine höhere Planarität nach Planarisierungsschritten ermöglicht.
- Bestehen die Nutzstrukturen und die Füllstrukturen aus leitfähigem Material, so kann es im Betrieb zu einer Aufladung der Füllstrukturen kommen. Um diese zu vermeiden, werden die

2

Füllstrukturen auf ein festes Potential gelegt, wie bei Widmann et al gezeigt. Diese Kontaktierung erfolgt über eine spezielle Verdrahtung, die in einer über den Nutz- und Füllstrukturen angeordneten Metallisierungsebenen angeordnet ist. Diese zusätzliche Verdrahtung und die Kontakte zwischen der zusätzlichen Verdrahtung und den Füllstrukturen erschwert die Erstellung des Layouts.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine integrierte

Schaltungsanordnung anzugeben, die mit hoher Planarität herstellbar ist, bei der eine Aufladung elektrisch leitender
Füllstrukturen vermieden wird und für die das Layout mit verringertem Aufwand erstellbar ist. Ferner soll ein Verfahren
zur Herstellung einer solchen Schaltungsanordnung angegeben
werden.

Dieses Problem wird erfindungsgemäß gelöst durch eine integrierte Schaltungsanordnung gemäß Anspruch 1 sowie durch ein Verfahren zu deren Herstellung gemäß Anspruch 8. Weitere Ausgestaltungen der Erfindung gehen aus den übrigen Ansprüchen hervor.

20

25

30

35

In der integrierten Schaltungsanordnung ist in einem Halbleitersubstrat ein dotiertes Gebiet vorgesehen. An der Oberfläche des Halbleitersubstrats ist eine Ebene mit leitenden Nutzstrukturen und mindestens einer leitenden Füllstruktur angeordnet. Die leitenden Nutzstrukturen sind zum Beispiel Anschlußelektroden, Gateelektroden, Leiterbahnstücke, Verdrahtungen oder ähnliches. Die leitende Füllstruktur ist mit dem dotierten Gebiet leitend verbunden. Als dotiertes Gebiet ist zum Beispiel der Substratkörper selbst oder eine dotierte Wanne, in der aktive Bauelemente angeordnet sind, geeignet. Der Substratkörper und/oder die dotierte Wanne, in denen Bauelemente angeordnet sind, werden in integrierten Schaltungsanordnungen ohnehin beim Betrieb mit einer festen Versorgungsspannung beaufschlagt. Die Verbindung mit der leitenden Füllstruktur stellt sicher, daß auch die leitende Füllstruk-

```
tur auf diesem potential liegt. Feerem porential verhunden
                                                            tur auf diesem Potential liegt. Da die potential verbunden sch
der Substratkörper ohnehin mit festem potential integrierten sch
der kann enmit in der erfindungsgemäßen integrierten sch
                                                                      der Substratkörper ohnehin mit festem potential verbunden and mit festem potential verbunden schal-
mit festem potential verbunden schal-
mit festem potential verbunden and and mit schal-
mit festem potential verbunden
integrierten schal-
mit festem potential verbunden
schal-
mit festem potential verbunden
schal-
mit sestem potential verbunden
schal-
mit substratkörper ohnehin mit sestem verdrahrung
schal-
mit substratkörper oh
                                                                                   sind, kann somit in der erfindungsgemäßen integrierten schal die nur zu dem verdrahtung, vorgesehen wird.

tungsanordnung die zusätzliche rillistrukturen vorgesehen wird.
                                                                                             tungsanordnung die zusätzliche Verdrahtung, die nur zu dem vorgesehen wird, inch das Füllstrukturen vorgesehen inch zu kann inch zusätzliche verdrahtung, die zusätzliche Verdrahtung, die nur zu dem vorgesehen wird, zu kann inch zusätzliche verdrahtung, die nur zu dem zusätzliche verdrahtung, die nur zu dem vorgesehen wird, zu dem zu dem vorgesehen wird, zu dem zu dem zu dem vorgesehen wird, zu dem zu dem zu dem vorgesehen wird, zu dem zu dem vorgesehen wird, zu dem zu dem vorgesehen wird, zu dem zu de
                                                                                                        Zweck des Anschlusses der Füllstrukturen vorgesenen wird, werden sich das Layout. Es kann werden sich das Layout. erstellt werden erstellt werden entfallen. Damit vereinfacht lavoutgenerierung erstellt werden entfallen. Damit vereinfacht lavoutgenerierung erstellt werden entfallen. Damit vereinfache Lavoutgenerierung erstellt werden entfallen.
WO 99/04431
                                                                                                                    entfallen. Damit vereinfacht sich das Layout. Es kann insher erstellt werden.

entfallen. Damit vereinfacht Layoutgenerierung erstellt herrimmhar herrimmhar sondere durch automatische jar nromrammmaeranert herrimmhar jar nromrammmaeranert herrimmhar internikriir jar nromrammmaeraner hier herrimmhar internikriir jar nromrammmaeraner hier internikriir jar nromrammaeraner hier internikriir hier nromrammaeraner hier internikriir hier internikriir
                                                                                                                           sondere durch automatische Layoutgenerierung erstellt werden.

sondere durch püllstruktur ist programmgesteuert bestimmbar.

pie Lage der
                                                                                                                                                    Vorzugsweise erfolgt die elektrische Verbindung der leitenden Gehier üher ein konrakrioch
                                                                                                                                                               Vorzugeweise erfolgt die elektrische Verbindung der leitende
Vorzugeweise erfolgt die elektrische über ein Kontaktloch

Vorzugeweise erfolgt dem dotierten gebiet über aie leitende

Kontaktloch

Verbindung der leitende

Vorzugeweise erfolgt die elektrische über ein Kontaktloch

Verbindung der leitende
                                                                                                                                                                        Füllstruktur mit dem dotierten gebiet überlappt die leitende oberfläch und einen Kontakt. Das Kontaktloch überlappt das oberfläch und einen Kontakt. Aas dotierte Gebiet so das das dotierte und einen Kontakt.
                                                                                                                                                                                    Rüllstruktur und das dotlerte Geblet, so das die Obertlache mit dem Gebietes mit dem Aer kontaktur und des dotlerten vontaktur und des kontaktur und Aer kontaktur der leitenden Füllstruktur erenen nac kontaktur in Vernindung erenen kontaktur in Vernindung erenen der leitenden in Vernindung erenen der kontaktur in Vernindung erene
                                                                                                                                                                                                           der leitenden Fullstruktur und des Kontaktloch und der """"""""

der leitenden Fullstruktur und Das Kontaktloch und kon-

kontakt in Verbindung gleichzeirin mit Konrakriächern """

kontakt vorzugsweise gleichzeirin mit konrakriächen
                                                                                                                                                                                                                      Kontakt in Verbindung stehen. Das Kontaktloch und der Kontakt

Kontakt in Verbindung stehen. Das Kontaktloch und kon-

kontakt in Verbindung stehen. Das Kontaktloch und kon-

ke sind dahe

kontakt in Verbindung stehen. Das Kontaktloch und kon-

ke sind dahe

kontakt in Verbindung stehen. Das Kontaktloch und der Kontakt

kontakt in Verbindung stehen. Das Kontaktloch und der Kontakt

kontakt in Verbindung stehen. Das Kontaktloch und der Kontakt

kontakt in Verbindung stehen. Das Kontaktloch und der Kontakt

kontaktloch und der Kontaktloch und kon-

ke sind dahe

kontaktloch und kontaktloch und kon-

ke sind dahe

kontakt in Verzugsweise gleichzeitig mit kontaktloch und kontaktloc
                                                                                                                                                                                                                                werden vorzugsweise gleichzeitig mit kontaktlochern und kon-
merden vorzugsweise gleichzeitig mit kontaktlochern ich
hergestellt. Es sind daher
hergestellt. Es sind daher
hergestellt. Asfür arfordarich
dafür arfordarich
                                                                                                                                                                                                                                         takten zu leitengen prozeßschritte dafür erforderlich.
keine zusätzlichen
                                                                                                                                                                                                                                                               Da nur sehr geringe Ströme (Aufladungen, jar ein überlannender werden missen) angeführt werden missen.
                                                                                                                                                                                                                                                                         Da nur sehr geringe Ströme (Aufladungen, ist ein überlappender werden müssen, ist ein überlappender auch heströme etc.) abgeführt wendig. Im prinzip genügt abgeführt wendig. Im prinzip genügt abgeführt wendig. Im prinzip genügt auch heströme etc.)
                                                                                                             10
                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kontakt nicht zwingend notwendig. Im Prinzip genugt auch
Kontakt nicht zwingend notwendig. Auch andere,
schon die Seitenwandkontaktfläche. hierzu geeignet
schon die Seitenwandkontaktfläche. hierzu geeignet
anleitungen ihrer Rauelemente sind hierzu geeignet.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           scnon die Seltenwandkontaktriache. Auch andere noch hierzu geeignet.

Ableitungen über Bauelemente sind hierzu geeignet.
                                                                                                                                                                    15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Zur Verbindung zwischen der leitenden Füllstruktur und dem zum der leitenden sind als Bauelemente ein Bauelement sind als hailweise ein der lein ein and nach feilweise ein dotierten gebiet über ein moc-mraneistor und letändig oder hailweise ein dotierten ein Moc-mraneistor
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       dotierten gebiet über ein Bauelement sind als Bauelemente zum (vollständig oder teilweise ein oder ähnli-
Beispiel ein MOS-Transistor geerhaltere ninden oder ander ander geerhalter)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Helsplel eln MUS-Translstor (vollständig oder teilweise ein-
(vollständig oder ånnli-
(vollständig oder teilweise ånnli-
(vollständig oder teilweise ånnli-
(vollständig oder teilweise ånnli-
(vollständig oder teilweise ein-
(vollständig oder teilweise ein-
(vollständig oder ånnli-
(vollständig oder teilweise ein-
(vollständig oder ånnli-
(volls
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                geschaltet), zwel gegenpolly geschaltete Dioden realisiert, zwel gegenpolly geschaltete dadurch realisiert, hinauenerihrt sie werden beispielsweise dadurch hinauenerihrt hinauenerihrt das Tenlarinnenehier hinauenerihrt das Tenlarinnenehier hinauenerihrt das Tenlarinnenehier hinauenerihrt das Tenlarinnenehier hinauenehier das Tenlarinnenehier hinauenerihrt das Tenlarinnenehier hinauenerihren das Tenlarinnenehier hinauenenehier hinauenen das Tenlarinnenehier hinauen das Tenlarinnen das Tenlarinnen das Tenlarinnen das Tenlarinnen das Tenlarinnen das Tenlarinnen das T
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           cnes geelgnet. Sie werden belspleiswelse dadurch hinausgeführt aum naienial geelgnet. Sie werden das Isolationsgebiet hinausgerührt aum naienial das die Füllstruktur über mit der Mittertruktur aum naienial daß die Füllstruktur wontakt mit der Mittertruktur und mittele kontakt mit der Mittertruktur und mitter mit der Mittertruktur und mitter
                                                                                                                                                                                                                             20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   daß die Füllstruktur über das Isolationsgebiet ninausgerunrt zum Reispiel wird und mittels Kontakt mit der Nutzstruktur, zum Reispiel wird wird und mittels verhinden wird
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Es liegt im Rahmen der Erfindung, oberhalb der Ebene, in der angeordner ist eine Metallistruktur angeordner ist eine Metallistruktur angeordner ist eine Metallistruktur
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Es liegt im Rahmen der Erfindung, oberhalb der Ebene, in der eine Metallisie-
gine in Rahmen der Erfindung, oberhalb der Ebene, in der eine Metallisie-
gine im Rahmen der Erfindung, oberhalb der Ebene, in der ist eine Metallisie-
gine im Rahmen der Erfindung, oberhalb der Ebene, in der ist eine Metallisie-
gine im Rahmen der Erfindung, oberhalb der Ebene, in der ist eine Metallisie-
gine im Rahmen der Erfindung, oberhalb der Ebene, in der ist eine Metallisie-
gine Metallisie-
g
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              dle leitende Fullstruktur angeordnet leitende Füllstruktur über eir rungsebene anzuordnen und die leitende rungsebene
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   einer Junction, verbunden wird.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       30
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                35
```

4

nen weiteren Kontakt mit der Metallisierungsebene zu verbinden. Diese Anordnung ist vorteilhaft, wenn die Metallisierungsebene, mit der die Füllstruktur über den weiteren Kontakt verbunden ist, im Betrieb auf demselben Potential wie das dotierte Gebiet liegt. Der Kontakt und der weitere Kontakt bilden in diesem Fall einen zusätzlichen integrierten Kontakt für das dotierte Gebiet.

Die Ebene, in der die leitende Füllstruktur angeordnet ist, kann sowohl eine Gateebene sein, die in der Nähe der Oberfläche des Halbleitersubstrats angeordnet ist, als auch eine Metallisierungsebene, die oberhalb der Gateebene und/oder weiterer Metallisierungsebenen angeordnet ist.

- Zur Herstellung der integrierten Schaltungsanordnung wird in dem Halbleitersubstrat ein dotiertes Gebiet gebildet. Auf dem Halbleitersubstrat wird durch Aufbringen und Strukturieren einer leitfähigen Schicht die Ebene mit leitenden Nutzstrukturen und mindestens einer leitenden Füllstruktur gebildet.
- 20 Es wird eine Isolationsstruktur erzeugt, die die leitenden Nutzstrukturen und die leitende Füllstruktur umgibt und bedeckt. Da die leitenden Nutzstrukturen und die leitende Füllstruktur aus der leitfähigen Schicht gebildet werden, weisen sie im wesentlichen die gleiche Höhe auf. Vorzugsweise wird
- die Verbindung zwischen dem dotierten Gebiet und der leitenden Füllstruktur durch Öffnen eines Kontaktloches, das die leitende Füllstruktur und das dotierte Gebiet überlappt, und Bildung eines Kontaktes erzeugt.
- 30 Es liegt im Rahmen der Erfindung, als Halbleitersubstrat eine monokristalline Siliziumscheibe, die monokristalline Siliziumscheibe, die monokristalline Siliziumschicht eines SOI-Substrates mit einer Trägerscheibe, einer isolierenden Schicht und einer monokristallinen Siliziumschicht oder ein Substrat, das SiC enthält, zu verwenden.

35

Die Verbindung der leitenden Füllstruktur mit dem dotierten Gebiet kann alternativ über eine lokale Verdrahtungsebene

```
Vorgenommen werden. Als lokale verdrahtungsebene wird verbin-
aer lararalan immahung wirkeama alaktrienh laitanda verbin-
                                             vorgenommen werden. Als lokale verdrahtungsebene wird verbin-
der lateralen Umgebung verdrahtungsebenen verden zum Rei-
der lateralen Lokale verdrahtungsebenen verden zum der lateralen. Lokale verdrahtungsebenen verden zum der lateralen bezeichnet.
                                                     der lateralen ungebung wirksame, elektrisch leitende verbin.

Verdrahtungsebenen werden zum Bei-

von streifenförmigen Teitern

in Form von streifenförmigen

aus Tisin
                                                            dung bezeichnet. Lokale von streifenförmigen Leitern, soge-
in Form von streifenförmigen Leitern, sepiel aus TiSi2-Strap, aebildet.
spiel aus TiSi2-Strap, nannten
WO 99104431
                                                                                      Für den Fall, daß die Ebene, jer anthalten die leitende Füllstruktur anthalten die leitende Füllstruktur anthalten die leitende Füllstruktur anthalten die leitende Füllstruktur der die leitende Füllstruktur der die leitende Füllstruktur anthalten die leitende Füllstruktur die leitende Füllstruktur anthalten die leitende Füllstruktur anthalten die leitende Füllstruktur die leitende Füllstruktur
                                                                                              Pür den Fall das die Ebene ist enthalten die leitenden können au angeordnet ist Gareelektroden. Die Gareelektroden hie Gareelektroden hie Gareelektroden hie Gareelektroden die leitenden können au angeordnet ist Gareelektroden. Die Gareelektroden hie Gareelektroden die leitenden können au angeordnet ist Gareelektroden die leitenden können au angeordnet ist dat eelektroden die leitenden können au angeordnet ist dat eelektroden die leitende kullistruktivatien die leitenden können au angeordnet ist dat eelektroden die leitenden können au angeordnet ist dat en dat en die leitenden können au angeordnet ist dat en d
                                                                                                    angeoranet let, gateelektroden. Die Gateelektroden and and Abraham Gateelektroden. Die Gateelektroden and Abraham Gateelektroden and Abraham Gateelektroden. Die Gateelektroden and Abraham Gateelektr
                                                                                                            Nutzstrukturen gateelektroden. Die Gateelektroden können aus der leitfähigen schicht, ale auch die leitende Fillstruktur gehilder wird ale auch die leitende Fillstruktur gehilder wird ale auch die leitende Fillstruktur gehilder wird ale dann auch die leitende Fillstruktur gehilder wird ale dann auch die leitende Fillstruktur gehilder wird ale dann auch die leitende Fillstruktur gehilder wird die le
                                                                       nannten TiSi2-Strap, gebildet.
                                                                                                                     wohl durch strukturierung einer leitfähigen wird, als auch dann auch die leitende mehrerer reilechichten genildet gehildet genilder werden dann auch die reiner mehrerer reilechichten genildet 
                                                                                                                             dann auch die leitende Füllstruktur gebildet werden.

dann strukturierung mehrerer Teilschichten gebildet werden.

durch Strukturierung
                                                                                                                                            Es liegt im Rahmen der Erfindung daß derjenige Teil des do-
rierten Gehietes.
                                                                                                                                                       Es liegt im Rahmen der Von dem Kontaktloch zur Verbindung mit daß derlenige Teil des dorwinden der Von dem Kontaktloch von Teilen des dorwinden der Von dem Kontaktloch von Teilen des dorwinden der Von dem Kontaktloch von Teilen des dorwinden von Teilen des dorwinden der liestenden Füllstruktur überlandt wird.
                                                                                                                                                             tierten Gebietes in denen aktive Elemente der Schaltungsan-
der leitenden in denen aktive Elemente der Schaltungsan-
tierten Gebietes.
                                                                                                                                                                     der leitenden Füllstruktur überlappt wird, von Teilen des do-
tierten Gebietes, sind durch eine Teolarioneerrukrur
tierten angenraner sind
                                                                                                                                                                                tierten Gebietes, in denen aktive Elemente der Schaltungsan-
tierten Gebietes, sind, durch eine Isolationsstruktur, arahen
ordnung angeordnet sind, janlierendem Material defillren Grahen
peigniel einen mit janlierendem Material
                                                                                                                                                                                      ordnung angeordnet sind, durch eine leolationsetruktur, zum

ordnung angeordnet sind, durch eine Material gefüllten Fall, f

Beispiel eine nas dorierre gehier reicht in diesem Fall, f

gerrennt eine
                                                                                                                                                                                              Beispiel einen mit lsollerendem Waterial getüllten Graben, na-
Beispiel einen mit lsollerte Gebiet reicht in diesem Fall

Beispiel einen mat lsollerte Gebiet renlationeernikriir

getrennt sind. Das dotierte ale die Tenlationeernikriir
                                                                                                                                                                                                      getrennt sind. Das dotierte gebiet reicht in diesem Fall ti
gebiet reicht in diesem Fall ti
na diesem Fall ti
gebiet reicht in dieser ran
na diesem Fall ti
als die Isolationsstruktur.
na diesem Fall ti
gebiet reicht in dieser ran
na diesem Fall ti
                                                                                                                                                                                                              fer in das Substrat hinein als die Isolationsstruktur. Da-
werden kurzschlüsse zwischen aktiven Elementen und dem
durch werden kurzschlüsse durch werden kontaut vormieden
                                                                                                                                                                                                                                      Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbei-
näher erläutert.

eniele dae in den Figuren dargestellt ist.
                                                                                                                        15
                                                                                                                                                                                                                                                 Im folgenden wird die Erfindung annand eines Austunrungsbei-
spiels, das in den Figuren dargestellt ist, näher erläutert.
                                                                                                                                                                                                                                                               Figur 1 zeigt einen schnitt durch ein Halbleitersubstrat mit
                                                                                                                                                                                                                            Kontakt vermieden.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Figur 2 Zeigt den Schnitt durch das Halbleitersubstrat leirfä
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                zelgt den schnicht durch das Halbleltersubstrat leitfä-
Bildung eines Gateoxids und Abscheidung einer leitfä-
higen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Figur 3 zeigt den schnitt durch das Halbleitersubstrat nach
                                                                                                                                                                                                          25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Strukturlerung der leltranigen und leitenden Füllstruk-
von leitenden Nutzstrukturen und leitenden Füllstruk-
                                                                                                                                                                                                                                                                                              35
```

6

turen und nach Bildung von Source-/Drain-Gebieten und einem Wannenkontakt.

- Figur 4 zeigt den Schnitt durch das Halbleitersubstrat nach

  Bildung einer planarisierenden Isolationsschicht.
  - Figur 5 zeigt den Schnitt durch das Halbleitersubstrat nach Bildung einer Zwischenoxidschicht.
- 10 Figur 6 zeigt den Schnitt durch das Halbleitersubstrat nach Bildung von Kontaktlöchern und Kontakten.
- Figur 7 zeigt den Schnitt durch das Halbleitersubstrat nach
  Bildung einer Metallisierungsebene und einem weiteren
  Kontakt zwischen der leitenden Füllstruktur und der
  Metallisierungsebene.

Die Darstellungen in den Figuren sind nicht maßstäblich.

In der Oberfläche eines Substrats 1 aus monokristallinem Silizium werden durch Ätzen von Gräben und Auffüllen der Gräben mit isolierendem Material Isolationsgräben 2 gebildet (siehe Figur 1). Das Auffüllen der Isolationsgräben 2 erfolgt durch planarisierende Schritte, zum Beispiel durch chemisch-

mechanisches Polieren. Anschließend wird unter Verwendung photolithographischer Prozeßschritte eine maskierte Ionenimplantation durchgeführt zur Bildung einer p-dotierten Wanne 3. Die dotierte Wanne 3 ist zum Beispiel mit Bor und einer Dotierstoffkonzentration von 5 x10<sup>17</sup> at/cm<sup>3</sup> dotiert.

30

35

Die dotierte Wanne 3 weist eine größere Tiefe als die Isolationsgräben 2 auf. Die dotierte Wanne 3 wird seitlich von einem der Isolationsgräben 2 umgeben. Ein weiterer Isolationsgraben 2 ist innerhalb der dotierten Wanne 3 so angeordnet, daß die dotierte Wanne 3 in einem aktiven Gebiet 4 und in ei-

nem Anschlußgebiet 5 an die Oberfläche des Substrats 1 an-

7

grenzt. Das aktive Gebiet 4 ist zur Aufnahme aktiver Elemente vorgesehen.

Die Tiefe der dotierten Wanne 3 beträgt zum Beispiel 1  $\mu$ m. Die Tiefe der Isolationsgräben 2 beträgt zum Beispiel 400 nm.

Anschließend wird zum Beispiel durch thermische Oxidation ein Gateoxid 6 gebildet (siehe Figur 2). Das Gateoxid 6 wird zum Beispiel in einer Schichtdicke von 6 nm gebildet. Anschließend wird eine leitfähige Schicht 7 abgeschieden. Für die leitfähige Schicht 7 ist jedes Material geeignet, das zur Bildung von Gateelektroden geeignet ist, insbesondere dotiertes Polysilizium, Metallsilizid, TiN. Die leitfähige Schicht 7 wird in einer Schichtdicke von zum Beispiel 200 nm gebildet.

Unter Verwendung photolithographischer Prozeßschritte wird die leitfähige Schicht 7 so strukturiert, daß daraus leitfähige Nutzstrukturen 71 und leitende Füllstrukturen 72 gebildet werden (siehe Figur 3). Die leitenden Nutzstrukturen 71 sind zum Beispiel Gateelektroden. Die leitenden Füllstrukturen 72 sind schaltungstechnisch ohne Funktion. Sie werden so angeordnet, daß eine gleichmäßige geometrische Belegung durch die leitenden Nutzstrukturen und die leitenden Füllstrukturen gegeben ist.

Durch konforme Abscheidung und anisotropes Rückätzen einer  $SiO_2$ -Schicht werden an den Flanken der leitenden Nutzstruktur 71 und der leitenden Füllstruktur 72  $SiO_2$ -Spacer 8 gebildet.

30

35

Durch maskierte Ionenimplantation, bei der die Oberfläche des aktiven Gebietes 4 freiliegt, die Oberfläche des Anschlußgebietes 5 jedoch abgedeckt ist, werden Source-/Drain-Gebiete 9 selbstjustiert zu der leitenden Nutzstruktur 71 gebildet. Die Source-/Drain-Gebiete 9 sind zum Beispiel mit Arsen oder Phosphor dotiert und weisen eine Dotierstoffkonzentration von 8 x  $10^{19}$  at/cm³ auf.

8

Anschließend wird unter Verwendung einer weiteren Maske, die das aktive Gebiet 4 abdeckt, das Anschlußgebiet 5 jedoch unbedeckt läßt, ein Wannenkontakt 10 gebildet. Der Wannenkontakt 10 wird zum Beispiel mit Bor dotiert und weist eine Dotierstoffkonzentration von 6 x  $10^{19}$  at/cm³ auf.

Anschließend wird eine planarisierende Isolationsschicht 11 gebildet, die durch chemisch-mechanisches Polieren soweit zurückgeschliffen wird, daß sie in der Höhe mit der leitenden Nutzstruktur 71 und den leitenden Füllstrukturen 72 abschließt (siehe Figur 4). Beim Planarisieren der planarisierenden Isolationsschicht 11 wirken die leitende Nutzstruktur 71 und die leitenden Füllstrukturen 72 als Planarisierungsstützstellen.

10

15

Anschließend wird eine erste Zwischenoxidschicht 12 abgeschieden. Mit Hilfe photolithographischer Prozeßschritte und anisotropem Trockenätzen werden Kontaktlöcher zu den Source-/Drain-Gebieten 9, zu der leitenden Nutzstruktur 71 und zu 20 dem Wannenkontakt 10 und den benachbarten leitenden Füllstrukturen 72 geätzt (siehe Figur 6). Durch Auffüllen der Kontaktlöcher mit Metall, zum Beispiel Wolfram, werden Kontakte 131 zu den Source-/Drain-Gebieten 9 und der leitenden Nutzstruktur 71 und ein überlappender Kontakt 132 zu dem Wan-25 nenkontakt 10 und den benachbarten leitenden Füllstrukturen 72 gebildet (siehe Figur 6). Der überlappende Kontakt 132 steht sowohl mit der Oberfläche der benachbarten leitenden Füllstrukturen 72 als auch mit der Oberfläche des Wannenkontaktes in Verbindung. Dadurch werden die Füllstrukturen 72 30 über den Wannenkontakt 10 mit der dotierten Wanne 3 verbunden.

Alternativ wird der überlappende Kontakt 132 so angeordnet,

daß er auf die Oberfläche des Substrats 1 trifft. In diesem
Fall wird ein Substratkontakt an der Oberfläche des Substrats

9

1 durch Implantation mit Dotierstoff, das denselben Leitfähigkeitstyp wie das Substrat aufweist bewirkt, gebildet.

Nachfolgend wird eine zweite Zwischenoxidschicht 14 abgeschieden, in der ein weiteres Kontaktloch, das auf den überlappenden Kontakt 132 trifft, geöffnet wird. Das weitere Kontaktloch wird mit einem weiteren Kontakt 15 zum Beispiel aus Wolfram aufgefüllt. Schließlich wird eine Metallisierungsebene 16 gebildet, die mit dem weiteren Kontakt 15 in Verbindung steht (siehe Figur 7). Die Metallisierungsebene 16 wird im Betrieb der Schaltungsanordnung auf das gleiche Potential wie die dotierte Wanne 3 gelegt.

10

## Patentansprüche

10

20

25

- 1. Integrierte Schaltungsanordnung,
- 5 bei der in einem Halbleitersubstrat (1) mindestens ein dotiertes Gebiet (3) vorgesehen ist,
  - bei der an der Oberfläche des Halbleitersubstrats (1) eine Ebene mit leitenden Nutzstrukturen (71) und mindestens einer leitenden Füllstruktur (72) angeordnet ist,
  - bei der die leitende Füllstruktur (72) mit dem dotierten Gebiet (3) leitend verbunden ist.
- 2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, bei der die leitenden Nutzstrukturen (71) und die leitende Füllstruktur (72) im wesentlichen die gleiche Höhe aufweisen und von einer planarisierenden Isolationsschicht (11, 12) umgeben sind.
  - 3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, bei der die leitende Füllstruktur (72) über ein Kontaktloch und einen Kontakt (132) mit dem dotierten Gebiet verbunden ist.
- 4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, bei der das Kontaktloch die leitende Füllstruktur (72) und das dotierte Gebiet (3) überlappt, so daß die Oberfläche der leitenden Füllstruktur (72) und des dotierten Gebietes (3) 30 mit dem Kontakt (132) in Verbindung stehen.
  - 5. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der die leitenden Nutzstrukturen (71) Gateelektroden sind und bei dem die leitende Füllstruktur (72) das Material der Gateelektrode enthält.
  - 6. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,

11

bei der das dotierte Gebiet (3) eine dotierte Wanne oder das Halbleitersubstrat ist.

7. Schaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

- bei dem oberhalb der Ebene, in der die leitende Füllstruktur (72) angeordnet ist, eine Metallisierungsebene (16) angeordnet ist,
- bei dem die leitende Füllstruktur (72) über einen weiteren Kontakt (15) mit der Metallisierungsebene (16) verbunden ist.
- 8. Verfahren zur Herstellung einer integrierten Schaltungsan-15 ordnung,
  - bei dem in einem Halbleitersubstrat (1) ein dotiertes Gebiet (3) gebildet wird,
- 20 bei dem auf dem Halbleitersubstrat (1) durch Aufbringen und Strukturieren einer leitfähigen Schicht (7) eine Ebene mit leitenden Nutzstrukturen (71) und mindestens einer leitenden Füllstruktur (72) gebildet wird,
- 25 bei dem eine Isolationsschicht (11, 12) erzeugt wird, die die leitenden Nutzstrukturen (71) und die leitende Füllstruktur (72) umgibt und bedeckt,
- bei dem eine leitende Verbindung zwischen der leitenden
   Füllstruktur (72) und dem dotierten Gebiet (3) erzeugt wird.
  - 9. Verfahren nach Anspruch 8,
- 35 bei dem in der Isolationsschicht (11, 12) ein Kontaktloch geöffnet wird, das die leitende Füllstruktur (72) und das dotierte Gebiet (3) jeweils teilweise überlappt, so daß die

12

Oberfläche des dotierten Gebietes (3) und der leitenden Füllstruktur (72) teilweise freigelegt wird,

- bei dem in dem Kontaktloch ein Kontakt (132) gebildet wird, der mit der Oberfläche der leitenden Füllstruktur (72) und des dotierten Gebietes (3) in Verbindung steht.
  - 10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
- 10 bei dem oberhalb der Ebene, in der die leitende Füllstruktur (72) angeordnet ist, eine Metallisierungsebene (16) erzeugt wird,
- bei dem ein weiterer Kontakt (15) erzeugt wird, über den
   die leitende Füllstruktur mit der Metallisierungsebene (16) verbunden wird.

FIG 1

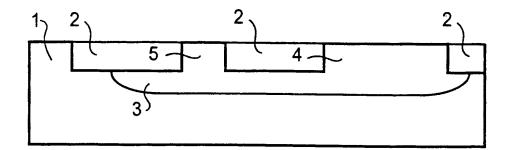
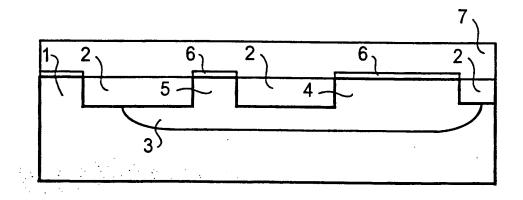


FIG 2



		•
		•
		,

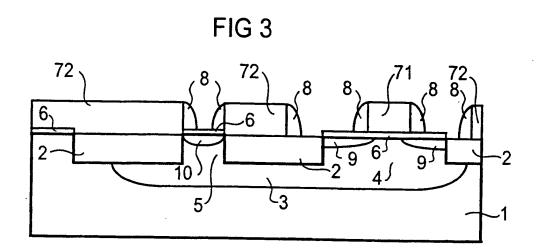
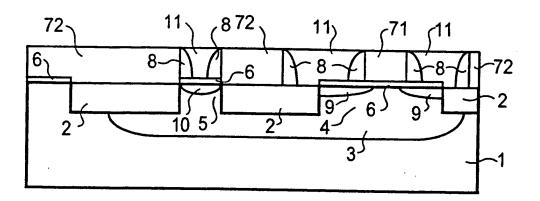


FIG 4



			X.
			•
			•

FIG 5

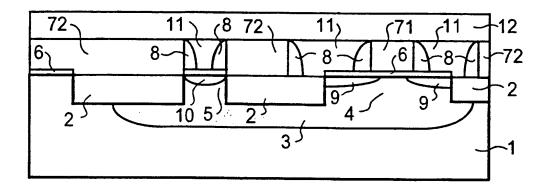
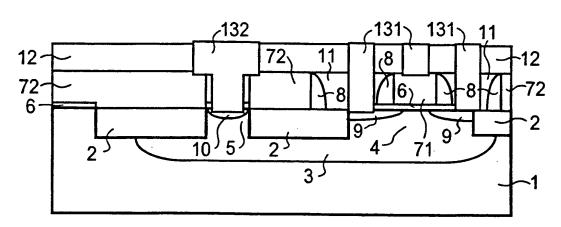
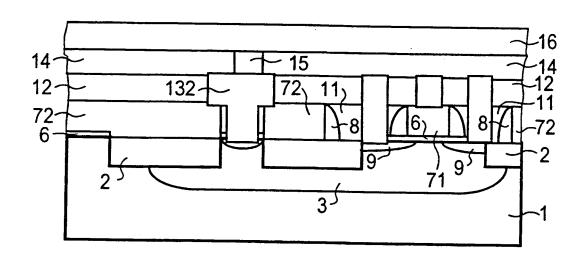


FIG 6

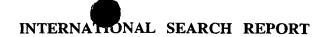


		-
		^
		•

FIG 7



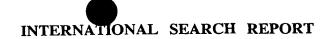
		A.
		,



International Application No
PCT/DE 98/01312

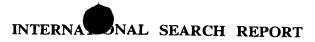
A. CLASS IPC 6	IFICATION OF SUBJECT MATTER H01L23/485 H01L21/768		
	o International Patent Classification(IPC) or to both national classifi	cation and IPC	
	SEARCHED		
IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classification H01L		
	tion searched other than minimum documentation to the extent that		
	ata base consulted during the International search (name of data b	ase and, where practical, search to	erms used)
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		<del></del>
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	levant passages	Relevant to claim No.
Х	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 097, no. 001, 31 January 19 & JP 08 236767 A (MATSUSHITA EL CO LTD), 13 September 1996 see abstract	97 ECTRIC IND	1,8
	& US 5 698 902 A (TAKASHI UEHARA 16 December 1997 	ET AL.)	
X	US 4 945 067 A (HUANG TIAO-YUAN) 31 July 1990 see abstract		1,8
A	US 5 441 915 A (LEE JIN-YUAN) 15 August 1995 see figure 12		1,8
	- <del></del>	-/	
<u> </u>	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members a	are listed in annex.
"A" documer conside "E" earlier di filing da "L" documer which is citation "O" documer other m "P" documer later the	nt which may throw doubts on priority claim(s) or so cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or leans at published prior to the international filing date but an the priority date claimed	cited to understand the princinvention  "X" document of particular releval cannot be considered novel involve an inventive step wh  "Y" document of particular releval cannot be considered to invodocument is combined with	onflict with the application but ciple or theory underlying the unce; the claimed invention or cannot be considered to element the document is taken alone unce; the claimed invention olve an inventive step when the one or more other such docuping obvious to a person skilled
	ctual completion of the international search  October 1998	Date of mailing of the internal	tional search report
		10/11/1998	
Name and m	ailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer  Köniastein. (	c

1





C.(Continue	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	D. WIDMANN, H. MADER, H.FRIEDRICH: "Technologie hochintegrierter Schaltungen" SPRINGER VERLAG,1996, pages 346-347, XP002082112 cited in the application see the whole document	



Information on patent family members

International Application No PCT/DE 98/01312

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 4945067	A	31-07-1990	US DE DE EP JP	4907041 A 68910249 D 68910249 T 0359528 A 2135780 A	06-03-1990 02-12-1993 19-05-1994 21-03-1990 24-05-1990
US 5441915	Α	15-08-1995	US	5789313 A	04-08-1998

			٠
			•
			•
	-		

## INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 98/01312

A. KLASSI IPK 6	ifizierung des anmeldungsgegenstandes H01L23/485 H01L21/768		
	iternationalen Patentklassifikation (iPK) oder nach der nationalen Klas RCHIERTE GEBIETE	ssifikation und derIPK	
Recherchie	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ote )	
IPK 6	H01L		
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		<del></del>
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1,8
	vol. 097, no. 001, 31. Januar 199 & JP 08 236767 A (MATSUSHITA ELE		
	CO LTD), 13. September 1996	CONTO THE	
	siehe Zusammenfassung & US 5 698 902 A (TAKASHI UEHARA	ET AI \	
	16. Dezember 1997	ET AL.)	
Х	US 4 945 067 A (HUANG TIAO-YUAN)		1,8
	31. Juli 1990 siehe Zusammenfassung		
Α	US 5 441 915 A (LEE JIN-YUAN) 15. August 1995		1,8
	siehe Abbildung 12		
		-/	
		,	
	·		
V Weit	l tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamilie	
entn	ehmen		internalismalan Apmaldadatum
"A" Veröffe	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu	t worden ist und mit der r zum Verständnis des der
	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Idedatum veröffentlicht worden ist	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedei	
echain	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	kann allein aufgrund dieser Veröffentli	chung nicht als neu oder auf
soll od ausget	en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Ier die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt)	kann nicht als auf erfinderischer Latigk	eit perunend betrachtet
"O" Veröffe eine B	intlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann	Verbindung gebracht wird und
	ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselber	
Datum des /	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	cherchenberichts
2	6. Oktober 1998	10/11/1998	
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Königstein, C	

1



Internationales Aktenzeichen PCT/DE 98/01312

	C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	ienden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
A	D. WIDMANN, H. MADER, H.FRIEDRICH: "Technologie hochintegrierter Schaltungen" SPRINGER VERLAG,1996, Seiten 346-347, XP002082112 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument				

1

CRICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 98/01312

	Datum der Veröffentlichung			Datum der Veröffentlichung
Α	31-07-1990	US DE DE EP JP	4907041 A 68910249 D 68910249 T 0359528 A 2135780 A	06-03-1990 02-12-1993 19-05-1994 21-03-1990 24-05-1990
Α	15-08-1995	US	5789313 A	04-08-1998
		A 31-07-1990	A 31-07-1990 US DE DE EP JP	A 31-07-1990 US 4907041 A DE 68910249 D DE 68910249 T EP 0359528 A JP 2135780 A

